

天风证券股份有限公司
关于上海新阳半导体材料股份有限公司
集成电路关键工艺材料项目调整增加产能、追加投资的
核查意见

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“上海新阳”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司集成电路关键工艺材料项目调整增加产能、追加投资具体事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海新阳半导体材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕195 号），上海新阳于 2021 年 4 月向特定对象发行普通股（A 股）股票 22,732,486 股，募集资金总额 79,199.98 万元，扣除不含税发行费用后的募集资金净额为 78,753.97 万元。本次募集项目资金于 2021 年 4 月存入公司募集资金专用账户中。上述资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“众会字（2021）第 03522 号”《验资报告》验证。

根据公司 2020 年度向特定对象发行股票募集说明书，集成电路关键工艺材料项目拟投资总额 35,000.00 万元，其中拟使用募集资金 33,522.23 万元。由于公司本次实际募集资金净额少于《募集说明书》拟募集资金，为提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利开展，经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，公司根据实际发行募集情况，对部分募投项目募集资金投资额进行了调整，集成电路关键工艺材料项目拟使用募集资金金额调整为 21,200.00 万元。

二、本次调整增加产能、追加投资的相关情况

（一）项目基本情况

公司集成电路关键工艺材料项目由全资子公司合肥新阳半导体材料有限公司负责实施，该项目原计划总投资 35,000.00 万元，主要用于新建厂房、仓储设施、公用工程及综合办公楼、购置生产设备，提升公司半导体相关超纯化学材料产品生产制造能力，其中拟投入募集资金 21,200.00 万元，不足部分以公司自有资金投入。项目原计划建成芯片铜互连超高纯电镀液系列、芯片高选择比超纯清洗液系列等多项产品合计新增年产能 17,000 吨，项目规划产能具体情况如下：

产品系列	规划新增产能（吨/年）
芯片铜互连超高纯硫酸铜电镀液及晶体	6,500
芯片超纯清洗液系列	8,500
高分辨率光刻胶系列	500
芯片级封装与集成电路传统封装引线脚表面处理功能型化学材料系列	1,500
合计	17,000

截至 2024 年 3 月 13 日，集成电路关键工艺材料项目募集资金已使用完毕，募集资金投入进度完成 100%，项目已按计划总体完成了厂房及配套设施的建设。募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额	利息及理财收入扣除手续费净额	累计投入募集资金金额	节余募集资金金额
集成电路关键工艺材料项目	35,000.00	21,200.00	623.29	21,823.29	0.00

（二）项目调整增加产能、追加投资情况

全球半导体产业正处于持续增长的上行周期，同时中国境内新建代工产能加速扩张。在此双重利好的推动下，中国大陆半导体市场规模增速持续超越全球平均水平，有望成为全球半导体材料市场的领军者。在市场快速扩张的大环境下，公司业务迎来快速增长，订单量持续攀升。由于集成电路关键工艺材料项目厂房及附属设施建设为未来的扩展和升级预留了足够的空间，公司结合市

场需求变化情况及整体发展规划，拟优化生产线布局，实现厂房空间集约利用，通过调整增加产能、追加投资对项目原有规划产能进行优化及扩充，具体如下：

- 1、将芯片铜互连超高纯硫酸铜电镀液及晶体项目产能由 6,500 吨/年扩产至 14,000 吨/年；
- 2、将芯片超纯清洗液系列项目产能由 8,500 吨/年扩产至清洗液系列产品 9,000 吨/年；蚀刻液系列产品 13,500 吨/年；研磨液系列产品 7,000 吨/年；
- 3、考虑到核心关键设备（光刻机）未来仍将面临短缺，为提高关键设备的使用效率，优化公司产能布局，原计划建设年产能 500 吨高分辨率光刻胶系列产品产线，将不再由合肥新阳半导体材料有限公司实施（上述光刻胶项目未来计划由公司在上海化学工业区生产基地建设实施），并不再列入本次募投项目规划；
- 4、考虑到国产半导体材料市场的持续变化，公司未来将更加聚焦高端核心材料的产能布局，因此，原计划建设的“芯片级封装与集成电路传统封装引线脚表面处理功能型化学材料系列”产线项目将不再推进。

综上，经调整增加产能、追加投资后，集成电路关键工艺材料项目规划产能调整为：

产品系列	规划产能（吨/年）
芯片铜互连超高纯硫酸铜电镀液及晶体	14,000
芯片超纯清洗液系列产品	9,000
芯片超纯蚀刻液系列产品	13,500
芯片超纯研磨液系列产品	7,000
合计	43,500

调整增加产能后，项目总投资预计金额由 3.50 亿调整为 10.49 亿，由于集成电路关键工艺材料项目相关募集资金已全部使用完毕，因此上述项目调整后新增产能所需项目投资资金将使用公司自有资金实施完成。

根据项目产能规划的调整情况，为更准确地反映项目实际效益，公司对该项目预计效益进行重新论证。具体情况如下：

公司结合该项目目前经营情况及产能规划调整等因素调整预计效益测算后，项目内部收益率（税后）由 14.70%调整为 23.30%，本项目达产后预计每年营业收入由 55,050.20 万元调整为 187,825.01 万元，达产后年均净利润由 8,474.51 万元调整为 38,309.01 万元。项目预期效益良好，调整后的效益测算符合公司实际经营情况。

（三）项目进展情况

集成电路关键工艺材料项目相关募集资金已全部使用完毕，项目已于 2024 年第二季度开始试生产。后续扩建产能预计将于 2027 年 6 月底前全部完成。

三、对公司的影响

本次集成电路关键工艺材料项目调整增加产能、追加投资，是公司结合当前市场环境、整体发展布局及项目实际情况作出的审慎决策，有助于公司抓住市场发展机遇，优化布局，不会对公司的正常经营产生重大影响，符合公司的发展战略和全体股东的利益。

四、履行审批程序及相关意见

（一）董事会决议

公司于 2025 年 4 月 16 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于集成电路关键工艺材料项目调整增加产能、追加投资的议案》，同意公司集成电路关键工艺材料项目调整增加产能、追加投资，同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 16 日召开第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于集成电路关键工艺材料项目调整增加产能、追加投资的议案》。经审核，监事会认为：公司集成电路关键工艺材料项目调整增加产能、追加投资，是根据项目建设的实际情况作出的审慎决定，符合公司的发展战略和全体股东的利益。相关决策程序合法合规，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创

业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求。监事会同意集成电路关键工艺材料项目调整增加产能、追加投资，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

（三）独立董事专门会议意见

经审议，公司本次集成电路关键工艺材料项目调整增加产能、追加投资事项，符合市场趋势和公司发展战略。本次调整增加产能、追加投资事项符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害投资者利益的情形。独立董事一致同意该议案。

五、保荐机构核查意见

公司对集成电路关键工艺材料项目调整增加产能、追加投资的事项已经独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，上述事项还需提交公司股东大会审议；上述事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的规定。保荐机构对公司集成电路关键工艺材料项目调整增加产能、追加投资的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于上海新阳半导体材料股份有限公司集成电路关键工艺材料项目调整增加产能、追加投资的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

徐士锋

徐士锋

徐宏丽

徐宏丽



天风证券股份有限公司

2025年4月16日